M8 免洗焊锡膏

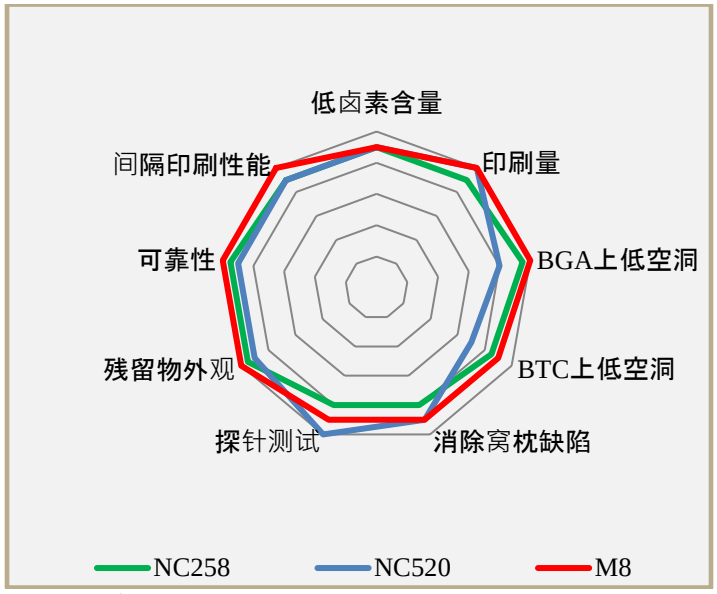
特性

- 低空洞缺陷：在 BGA 上<5%、BTC 元件上<10%
- 当面积比小于 0.5 时，具有优异的印刷效率
- 消除枕窝缺陷
- 符合 REACH 和 RoHS*
- 为 T4, T5 及更细的锡粉而开发
- 极强的润湿性适用于无铅表面镀层
- 极少的透明残留-兼容 LED
- 通过了 Bono 和汽车 SIR 测试

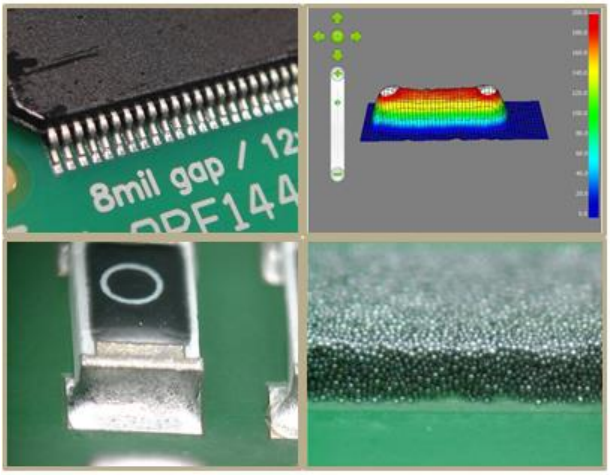
描述

M8 免洗焊锡膏大幅提高了性能。M8 为含铅及无铅的 T4, T5 及更细合金粉而开发，为 UFP 和 umBGA 提供稳定的印刷效率，可减少挑战性应用的缺陷。M8 独特的活化系统减少润湿相关的缺陷，如枕窝（HiP）缺陷并提供光滑闪亮的焊点。M8 将 BGA 上的空洞率降低至< 5% ；BTC<10%。M8 通过严格的汽车和高可靠性 SIR 测试以及电化学测试要求。

特性



*无铅合金



处理&储存

参数	时间	温度
冷藏密封保质期	1 年*	0°C-12°C (32°F-55°F)
非冷藏密封保质期	3 个月*	< 25°C (< 77°F)

*T4 型合金。联系 AIM 获取更细合金的保质期。

请勿将使用过的焊锡膏添加至未使用过的焊锡膏中。应单独存放；对未使用的焊锡膏，须将内盖或顶盖盖好并重新密封。开封后的焊锡膏保质期取决于环境和应用，详情请见 AIM 焊锡膏使用指导。合金的成分和储存条件可能会影响保质期。请参阅 M8 分析报告中的特定信息。

清洁

回流前:使用 AIM DJAW-10 可有效的清洗 M8 焊锡膏。DJAW-10 可自动或手动擦拭钢网。DJAW-10 不会使 M8 干燥，但可加强其印刷性。切勿过量使用 DJAW-10。请勿将 DJAW-10 用于钢网顶部。不建议在工艺过程中使用异丙醇，仅适用于最后清洗。

回流焊后残留物：M8 残留物无需清洗。在必须清洗的情况下，AIM 已与其工业合作伙伴合作确保 M8 残留物可使用普通除焊剂清洗。 联系 AIM 以获得清洗剂兼容性的信息。

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。**有关特定产品的信息，请参阅分析证书。**

负责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 http://www.aimsolder.com/terms-conditions 查询 AIM 相关条款。

回流曲线

如需获得详细回流曲线信息，请登录 http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements. 或联系 AIM 获取更多信息。

印刷

以下推荐的印刷机初始设定—取决于 PCB 和 PAD 设计	
参数	推荐初始设定
刮刀压力	0.4-0.7 公斤/25 毫米
刮刀速度	13 – 152 毫米/秒
接触距离	接触 0.00 毫米
PCB 分离距离	0.75 - 2.0 毫米
PCB 分离速度	3 - 20 毫米/秒
焊锡膏模板上寿命	>8 小时

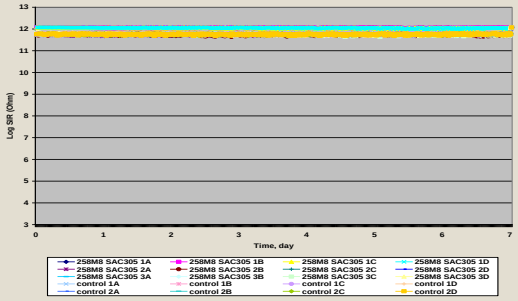
测试数据结论

注: 所有测试数据均适用于 SAC305 T4 配方

名称	测试方法	结果	
IPC 分类	J-STD-004 A	ROL0	
IPC 分类	J-STD-004 B, C	ROL1	
名称	**测试方法**	**典型结果**	**图像**
质量密度*		4.2 gr/cm3 (*SAC305)	
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	前 后
定量卤化物	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Cl: 0.0% 典型值	
定量卤化物、铬酸银测试	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	通过	
定量卤化物、氟化点	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	无氟化物	

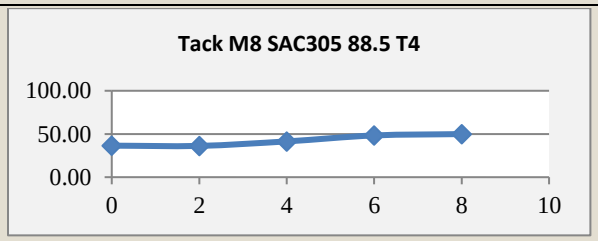
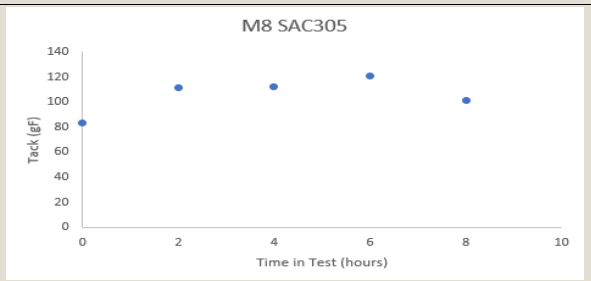
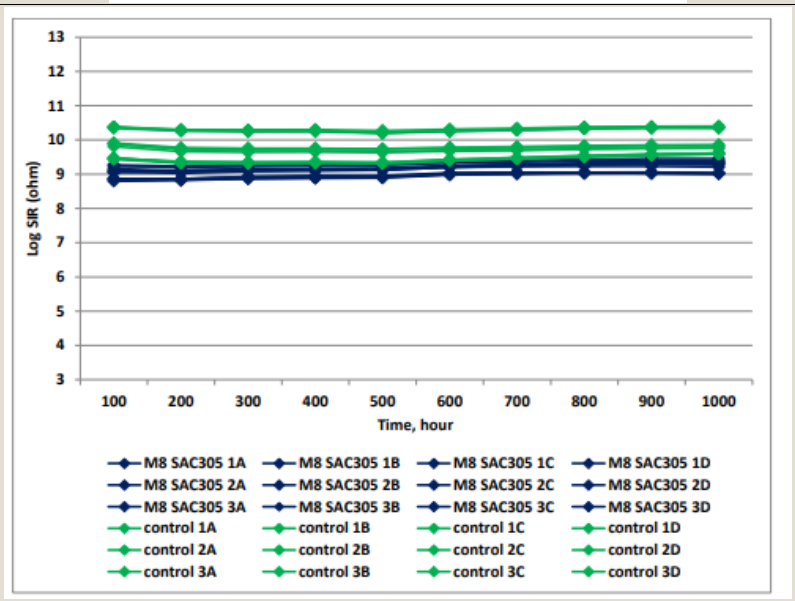
*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。**有关特定产品的信息，请参阅分析证书。**

负责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 http://www.aimsolder.com/terms-conditions 查询 AIM 相关条款。

名称	测试方法	典型结果	图像
表面绝缘电阻	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	所有测试都超过 100 MΩ	
Bono 测试		通过 Fc<8.0 典型值	
氧弹卤素测试	EN14582:2007 SW 9056 SW 5050	Cl <122 mg/Kg	
电化迁移	J-STD-004B 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	通过	
助焊剂残留物干燥度	IPC-TM-650 2.4.47	通过	前 后
助焊剂固体含量、非挥发性测定	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	94.8% 典型值	
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	136 mgKOH/g flux 典型值	
粘度 (Brookfield)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	400-1000 Kcps	
粘度 (Malcolm)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	70-300 Pa.S 典型值	
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	通过	
坍塌测试	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	通过	
散锡测试	J-STD-004B 3.7.2 IPC-TM-650 2.4.46	通过	

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。**有关特定产品的信息，请参阅分析证书。**

负责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 http://www.aimsolder.com/terms-conditions 查询 AIM 相关条款。

名称	测试方法	典型结果	图像
锡球测试	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	通过	 15 分钟 4 小时
粘性	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	36.1 gf Time 0 典型值	
粘性	JIS Z 3284	105.92 gf 典型值	
离子迁移	MS184-01, 4.3.5	通过	

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。**有关特定产品的信息，请参阅分析证书。**

负责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 http://www.aimsolder.com/terms-conditions 查询 AIM 相关条款。